附件2

# 深圳市工业和信息化局集成电路专项扶持计划操作规程（征求意见稿）编制说明

为规范市工业和信息化局集成电路产业发展专项扶持计划的组织实施，提高专项扶持计划的资金使用效益和管理水平，根据《深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019-2023）》(深府〔2019〕28号)、《关于加快集成电路产业发展的若干措施》（深府规〔2019〕4号）和《深圳市市级财政专项资金管理办法》(深府规〔2018〕12号)等文件精神,形成了《市工业和信息化局集成电路产业发展专项资金扶持计划操作规程（征求意见稿）》。现就有关情况说明如下：

一、编制背景

集成电路是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。在新一轮科技和产业革命的背景下，云计算、大数据、5G、人工智能、工业互联网、新能源智能网联汽车等新需求、新应用不断涌现。无论这些新兴领域如何发展演变，都离不开集成电路的支撑保障，并将进一步扩大对集成电路的应用需求。结合当前中美贸易冲突不断升级的全球背景，集成电路在经济发展中战略制高点的地位更加突出。

2014年6月24日，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》（下称《推进纲要》），指出“当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期”，部署“充分发挥国内市场优势，营造良好发展环境，激发企业活力和创造力，带动产业链协同可持续发展，加快追赶和超越的步伐，努力实现集成电路产业跨越式发展。”

书记、市长始终高度关注我市集成电路和第三代半导体等产业的发展，立新副市长也召开专题会议研究深圳集成电路产业发展，指示加快出台集成电路产业政策。为落实市政府要求，贯彻国家集成电路产业发展战略部署，抢抓集成电路产业发展重大机遇，我局通过深入调研，从顶层设计和具体措施两方面着手，研判了国内外产业发展的现状和趋势，分析了深圳市产业发展的现状、优势、机遇和不足，研究了深圳市发展集成电路的主要任务、重点发展领域、重大发展工程和保障措施，并在此基础上编制了《深圳市进一步推动集成电路产业发展五年行动计划（2019-2023）年》《关于加快集成电路产业发展的若干措施》。2019年3月1日，市政府六届一百六十一次常务会议通过了行动计划和若干措施。4月29日，市政府正式印发了《深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019-2023）》(深府〔2019〕28号)，市政府办公厅正式印发了《关于加快集成电路产业发展的若干措施》（深府规〔2019〕4号）。为落实若干措施中拟定的扶持条款，制定本操作规程。

二、主要内容

（一）第一章“总则”。

1.明确操作规程编制的政策背景，写明政策依据包括《深圳市进一步推动集成电路产业发展五年行动计划（2019-2023）》(深府〔2019〕28号)、《关于加快集成电路产业发展的若干措施》（深府规〔2019〕4号）、《深圳市市级财政专项资金管理办法》(深府规〔2018〕12号)等内容。

2.明确操作规程适用范围为扶持集成电路产业；明确扶持方式包括直接资助和融资租赁两种。

（二）第二章“**管理职责和分工”。**

明确市工业和信息化局、第三方机构和项目申报单位各自承担的主要职责。

（三）第三章“申报条件和资助标准**”。**

1.明确扶持资金申报的基础条件。

2.明确各扶持类别具体资助标准。

（四）第四章“项目申报和审核**”。**

**明确专项资金项目申报、审核、公示到资金拨付的基本流程。**

（五）第五章“项目管理和绩效评价”。

**根据**《深圳市市级财政专项资金管理办法》(深府规〔2018〕12号)要求，拟定项目管理和绩效评价要求。

（六）第六章“监督管理”。

**根据**《深圳市市级财政专项资金管理办法》(深府规〔2018〕12号)要求及近年来实际操作经验及我局专项资金改革方案，本着严谨、严肃的原则，明确监督管理内容。